



Dünndraht Wedge-Wedge Bonder

5330

Bond System

Drahttypen	Alu- und Golddrähte 17,5-75µm auf 2"-Spule Bändchen bis 250 µm Breite (optional)
Bondkopf	Wedge-Wedge für Alu- und Golddraht Standard Tool 1" Länge, 45° Drahtzuführung Motorisierte Drahtabspulung (optional)
Ultraschall System	F&S Generator 100kHz (optional 67, 140kHz)

Maschinen Basis

Achsen	<ul style="list-style-type: none"> • Programmierbare lineare Z-Achse mit 60mm Hub • Programmierbare lineare Y-Achse mit 20mm Hub • Standard-Arbeitshöhe: 55 mm • Manipulator in X und Y: 18x18 mm • entspricht Untersetzung: 1:7
Hardware	<ul style="list-style-type: none"> • Stepper-Motor getriebene Z-Linearachse, • Singleboard-PC, menügeführtes Teach-In, • interne Festplatte, Bedienung und Menüführung über Shuttlerad mit Quittierungstaster
Software	<ul style="list-style-type: none"> • programmierbare Einzelbonds • Loopformen speicherbar
Steuerung	Manuell, Teil-Automatisch
Abmessung	B x T x H – 63 x 58 x 40 cm, Gewicht ca. 30kg
Anschlüsse	100-230 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 230 VA Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch
Heizung	Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C

Die 53xx Serie:

Der Wedge-Wedge-Bonder 5330 verarbeitet Aluminium und Golddrähte von 17,5 bis 75 µm. Eine Klammerstellung ermöglicht auch Bonden von Bändchen bis 250 µm Breite.

Der Bondkopf ist mit einer automatischen Feed- und Tail-funktion ausgestattet, wodurch ein opti-males, bedienerfreundliches Bonden garantiert wird. Die Bedienführung über ein Farbdisplay und die Eingabe mittels Wählrad machen die Programmierung sehr einfach. Durch die motorgesteuerte Bewegung in der Y & Z-Achse haben Sie stets reproduzier-bare Bondergebnisse.

Zusätzlich können sämtliche Parameter auf der internen Festplatte gespeichert werden. Das erlaubt die Bedienung auch durch wenig geschultes Personal.

Wenn auch Sie für komplexe Bondaufgaben opti-male Qualität zum günstigen Preis suchen, ist diese Maschine genau richtig für Sie.

Substrathalter

Standard-Substrataufnahme
Mit mechanischer Klemmung
Ø80mm



Optional:



Substrataufnahme
für Bauteile bis 4x4" mit
Vakuum und mech. Klemmung



TO Aufnahme mit
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.
gummierter Oberfläche, mit
mechanische Klemmung

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270

Fax: +43-7722-67052-8272

Mail: info@fsbondtec.at

Web: www.fsbondtec.at

Hilpert
electronics

Ihr Vertriebspartner/ Votre représentant:

Hilpert electronics AG
Täferstrasse 29
5405 Baden-Dättwil
Schweiz / Suisse

Tel: +41 56 483 25 25
Fax: +41 56 483 25 20
Mail: office@hilpert.ch
Web: www.hilpert.ch

